



タツモ株式会社 決算説明資料

2025年12月期第2四半期

2025年8月8日

証券コード 6266

会社案内ダウンロード



INDEX

目次



1. 2025年12月期第2四半期 連結業績
2. セグメント別業績
3. 市場（顧客）の状況
4. 補足資料



1

2025年12月期第2四半期 連結業績

売上高

16,787百万円

前年比 +3.4%

営業利益

2,517百万円

前年比 △11.2%

経常利益

2,384百万円

前年比 △20.0%

親会社株主に帰属 する中間純利益

1,645百万円

前年比 △20.4%

■ 概況

- 売上高はプロセス機器事業で検収遅れが発生したことなどにより計画比を下回ったが、利益では半導体装置の量産による原価低減・収益性の改善効果によって計画を上回る結果となった。
- 表面処理用機器事業と金型・樹脂成形事業においては、生産性の効率化を進めた案件が検収となった。
- プロセス機器事業の受注状況は、市場の回復を待つ中で想定していたほどの成果は出ていない。アドバンスドパッケージ向け半導体装置の受注は想定よりも遅延傾向ではあるが、後半での増加を期待している。

前年同期比では利益率の高いパワー半導体向け装置の売上が減少したことで利益も減少。
一方、計画比では生産効率の改善効果等により想定を上回る大幅な増益を達成。

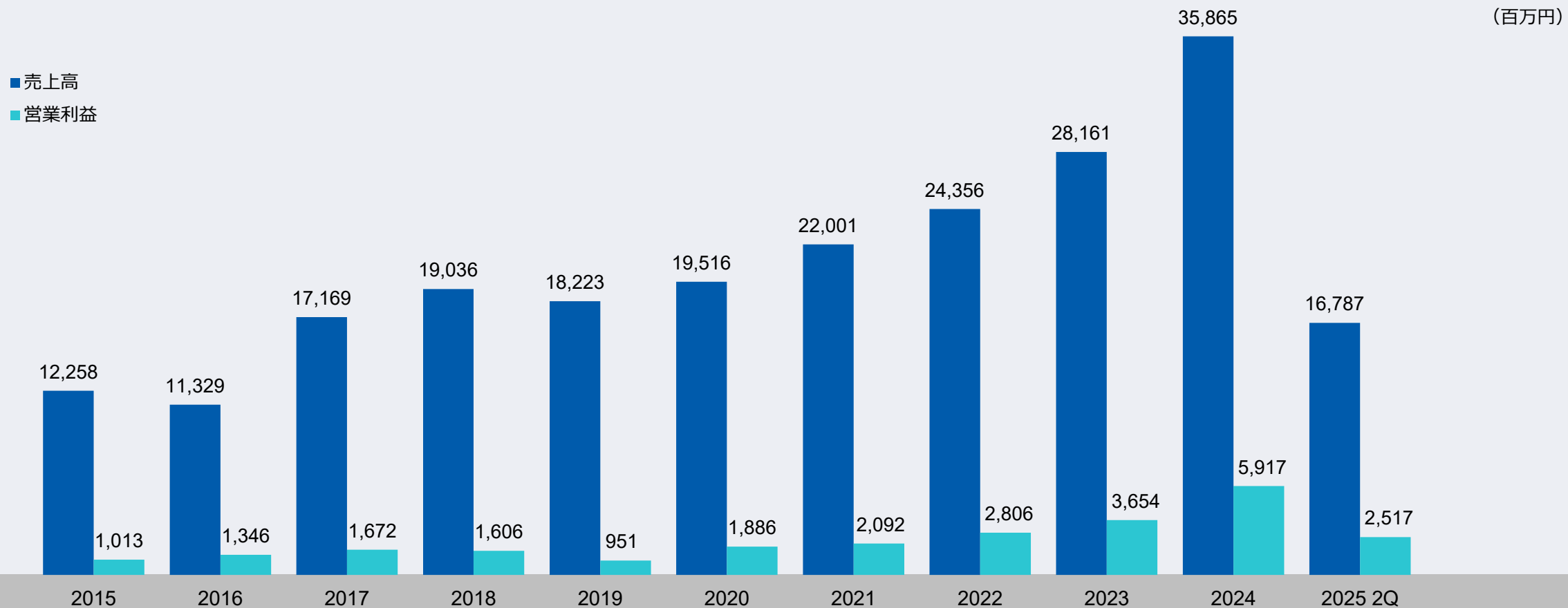
(百万円)	2024年12月期 Q2 実績	2025年12月期 Q2		前年同期比 増減率(%)	当初 2025年12月期 中間計画	当初中間 計画比 (%)	2025年12月期 通期計画	通期計画比 進捗率(%)
		実績	売上比(%)					
売上高	16,239	16,787	—	3.4	18,640	90.1	41,000	40.9
売上総利益	5,534	5,231	31.2	△5.5	—	—	—	—
営業利益	2,836	2,517	15.0	△11.2	1,930	130.4	5,000	50.3
経常利益	2,981	2,384	14.2	△20.0	1,920	124.2	5,100	46.7
親会社株主に 帰属する 当期純利益	2,067	1,645	9.8	△20.4	1,350	121.9	3,500	47.0

連結売上高・連結営業利益推移（四半期）



連結売上高・連結営業利益推移（通期）

TAZMO



(百万円)	2024年12月期 実績	2025年12月期 Q2 実績	前期末比増減
流動資産	40,731	39,983	△747
固定資産	8,469	8,563	93
有形固定資産	7,385	7,448	63
無形固定資産	156	166	9
投資その他資産	927	948	20
総資産合計	49,200	48,547	△653
流動負債	17,696	16,968	△727
固定負債	6,861	6,958	97
負債合計	24,557	23,927	△630
純資産合計	24,642	24,619	△22
自己資本比率	49.1%	49.9%	0.8P

主な増減

流動資産	(百万円)
現金及び預金	+ 2,653
電子記録債権	△950
棚卸資産	△1,232
流動負債	
電子記録債務	△2,004
契約負債	+ 1,455
短期借入金	+ 329
未払法人税等	△347
固定負債	
長期借入金	+159

(百万円)	2024年12月期 Q2 実績	2025年12月期 Q2 実績	前年同期比 増減
営業活動による キャッシュ・フロー	4,353	4,394	41
投資活動による キャッシュ・フロー	△971	△4,540	△3,569
フリー・キャッシュ・ フロー	3,382	△145	△3,528
財務活動による キャッシュ・フロー	△1,927	△556	1,371
現金及び現金同等物の 期末残高	8,589	8,719	130

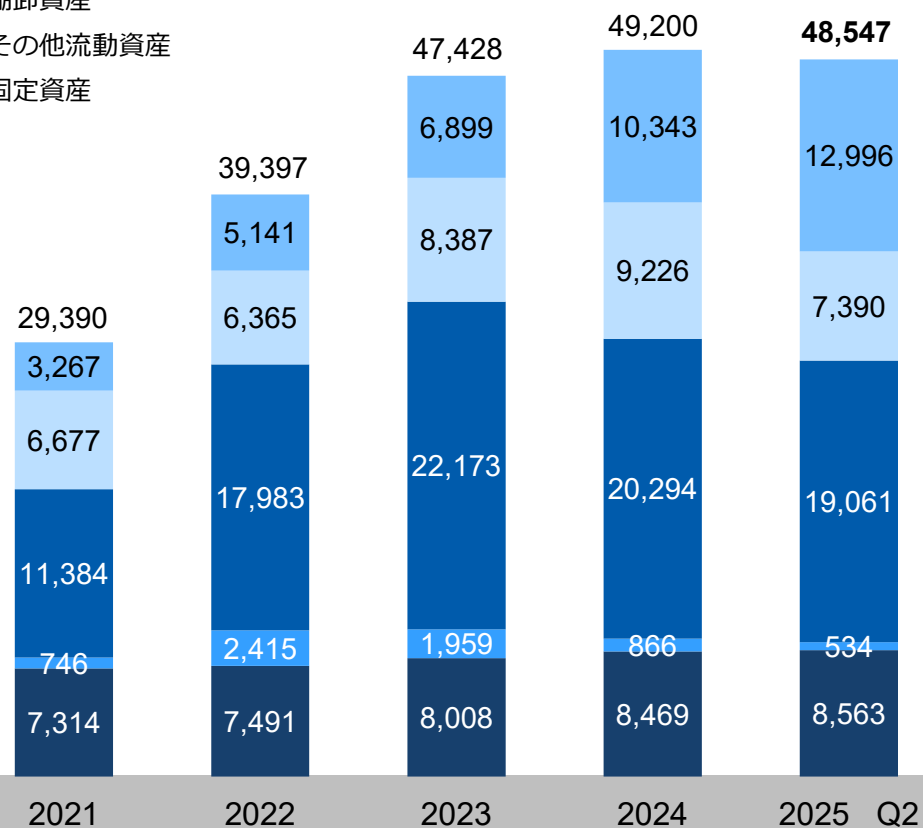
主な内訳

営業CF	(百万円)
税金等調整前当期純利益	2,400
契約負債	1,597
仕入債務	△1,897
売上債権	1,650
投資CF	
定期預金の純増減額	△3,759
有形固定資産の取得による支出	△749
財務CF	
長期借入れによる収入	2,000
長期借入金の返済による支出	△1,510
自己株式取得による支出	△511

資産

(百万円)

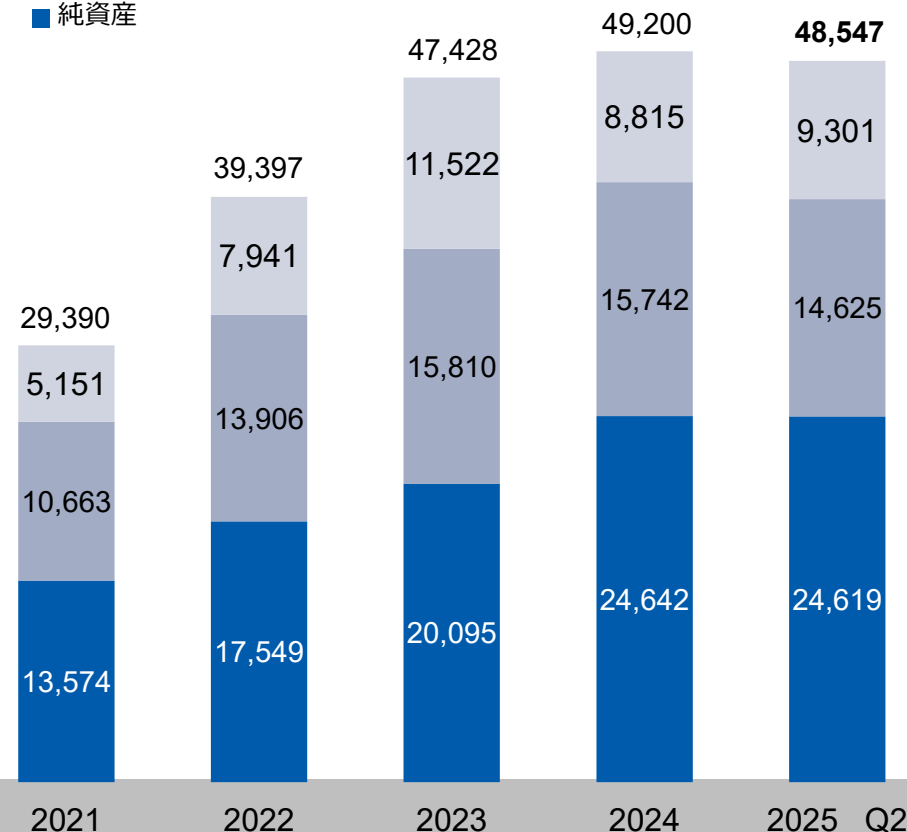
- 現金及び預金
- 売掛債権
- 棚卸資産
- その他流動資産
- 固定資産



負債／純資産

(百万円)

- 有利子負債
- その他負債
- 純資産





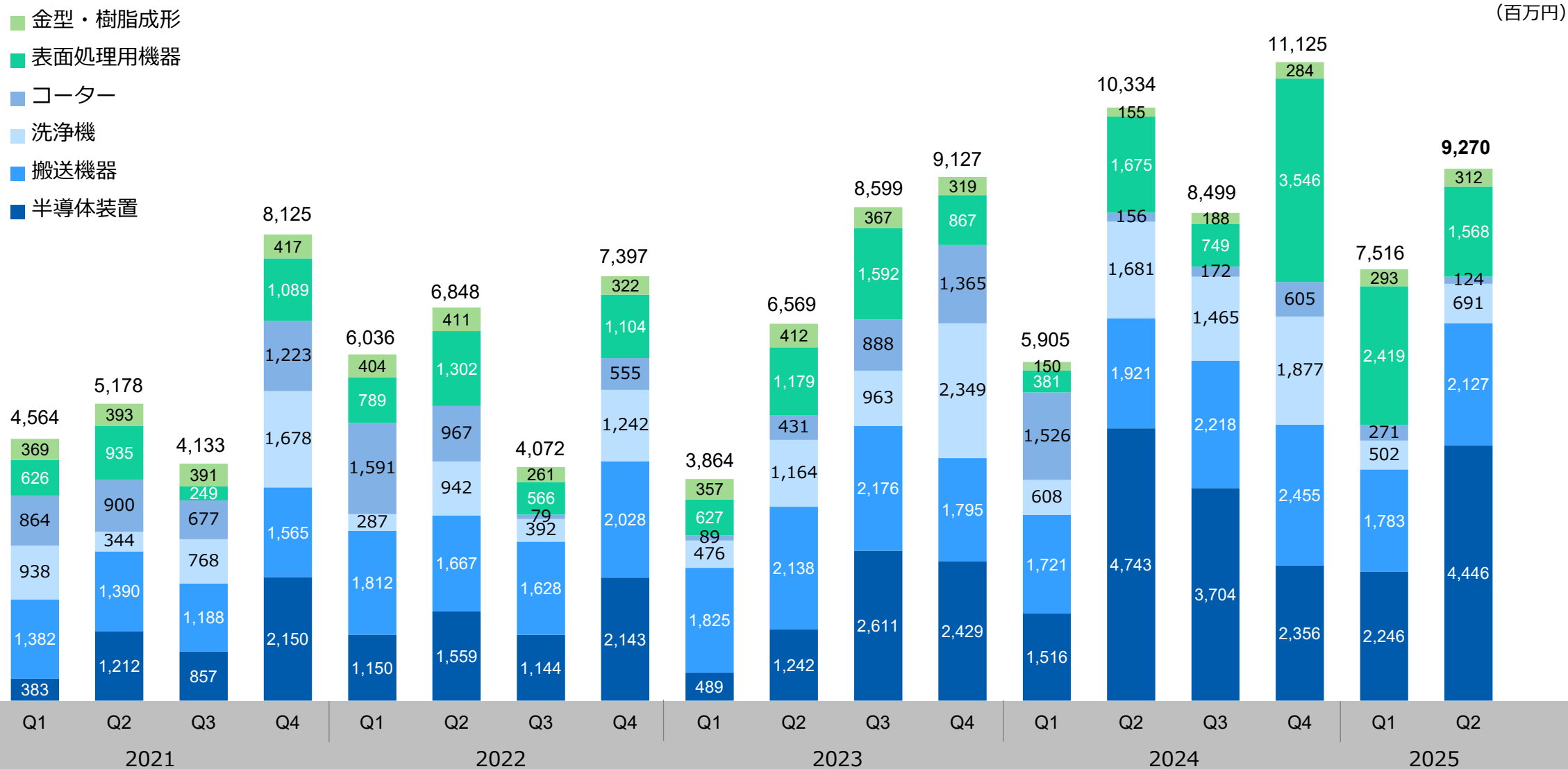
2

セグメント情報

(百万円)		2024年12月期 Q2 実績	2025年12月期 Q2 実績	前期比 増減率(%)
プロセス機器事業	売上高	13,877	12,193	△12.1
	営業利益	2,745	1,920	△30.0
■ 半導体装置	売上高	6,260	6,692	6.9
■ 搬送機器	売上高	3,643	3,911	7.3
■ 洗浄機	売上高	2,290	1,194	△47.9
■ コーター	売上高	1,683	396	△76.5
金型・樹脂成形事業	売上高	306	606	98.2
	営業利益	△101	56	—
表面処理用機器事業	売上高	2,056	3,987	93.9
	営業利益	177	517	191.0
セグメント間の内部売上高又は振替高	営業利益	15	△191	—
合計	売上高	16,239	16,787	3.4
	営業利益	2,836	2,517	△11.2

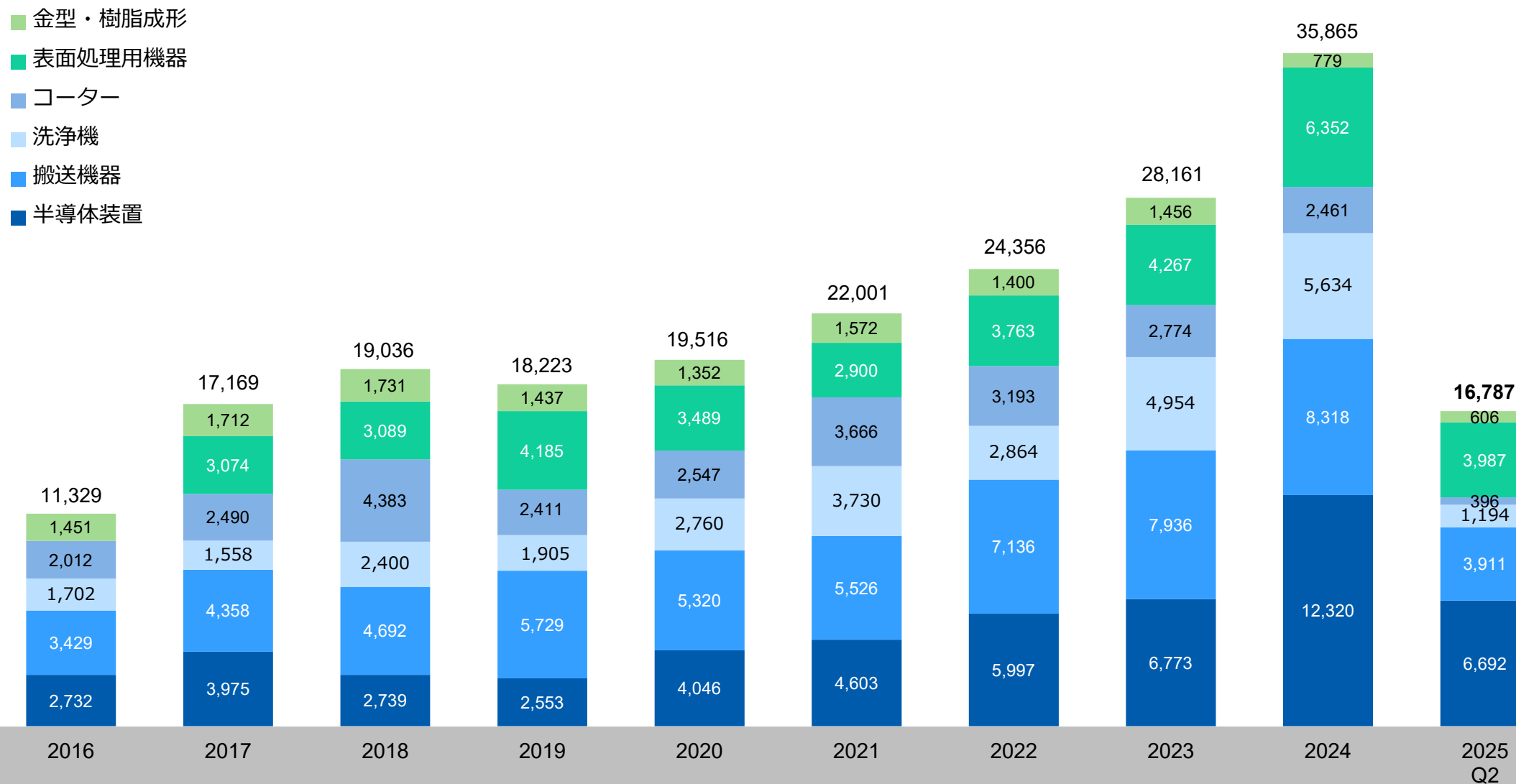
2025年 中間計画	中間計画比 (%)	2025年12月期 通期計画	通期計画比 進捗率(%)
13,900	87.7	33,000	36.9
1,550	123.9	4,500	42.7
—	—	18,200	36.8
—	—	9,300	42.1
—	—	3,700	32.3
—	—	1,800	22.0
540	112.2	1,100	55.1
20	280.0	50	112.0
4,200	94.9	6,900	57.8
360	143.6	450	114.9
—	—	—	—
18,640	90.1	41,000	40.9
1,930	130.4	5,000	50.3

セグメント別 売上高推移（四半期）



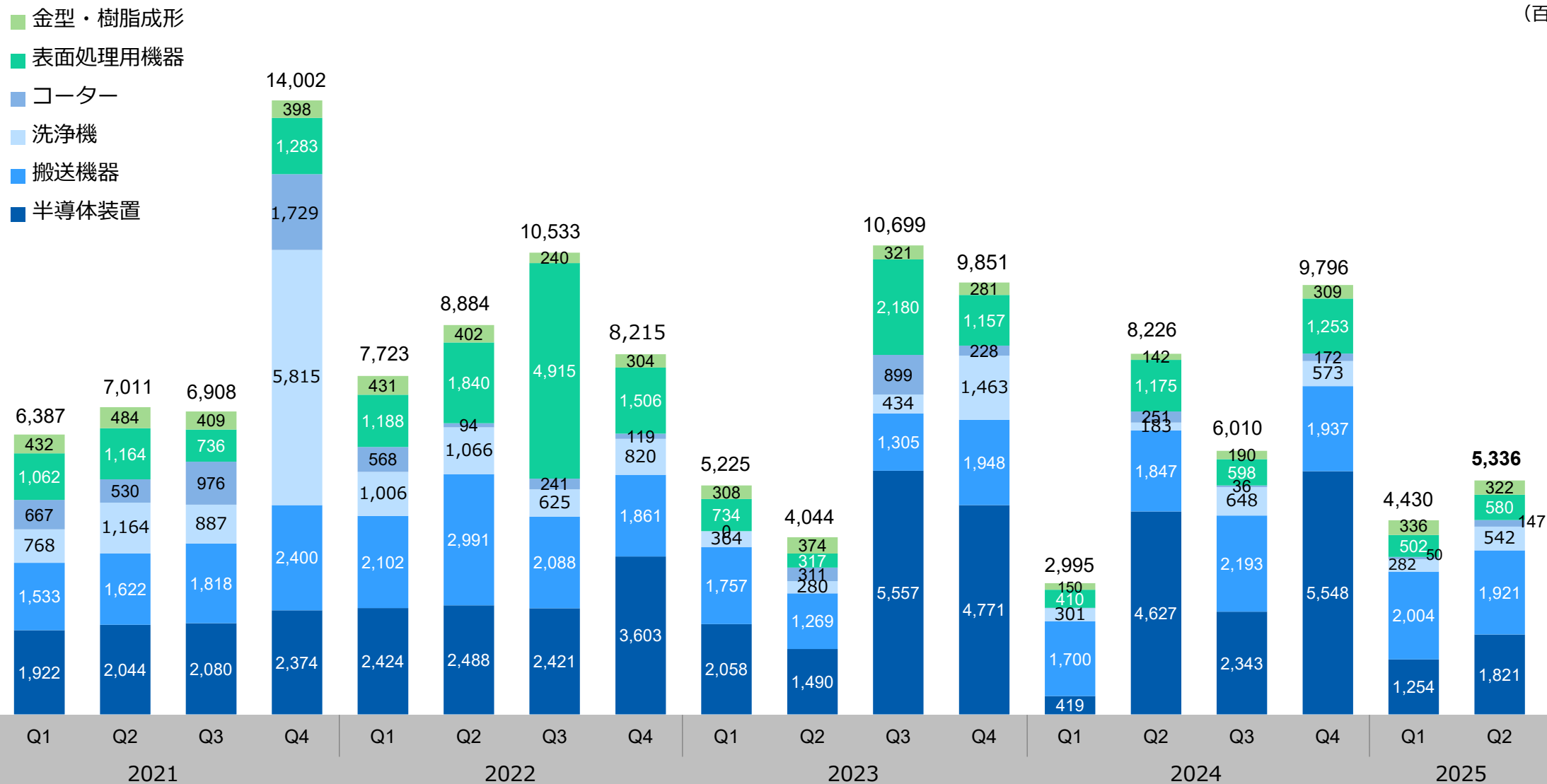
セグメント別 売上高推移（通期）

(百万円)

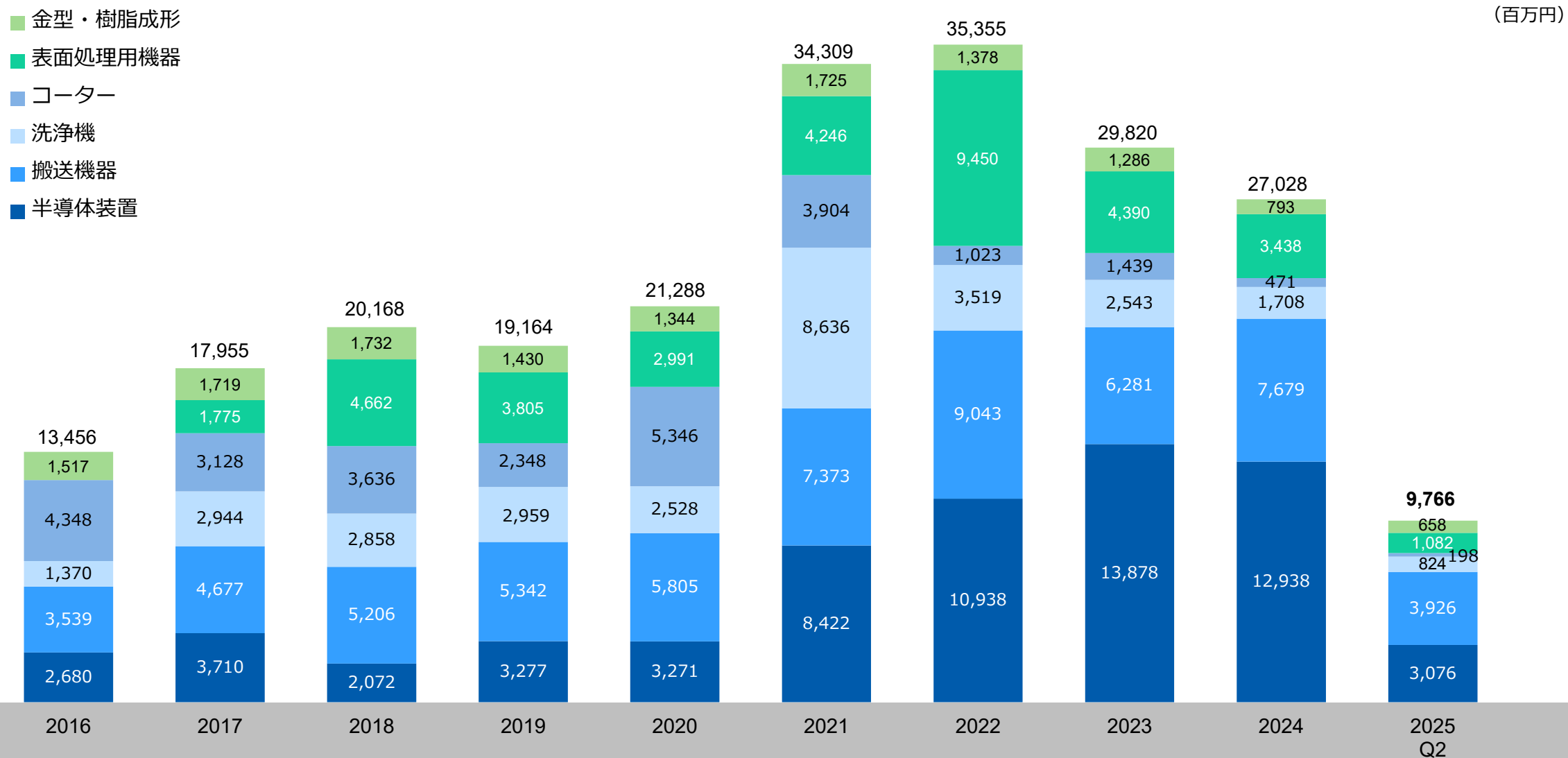


セグメント別 受注高推移（四半期）

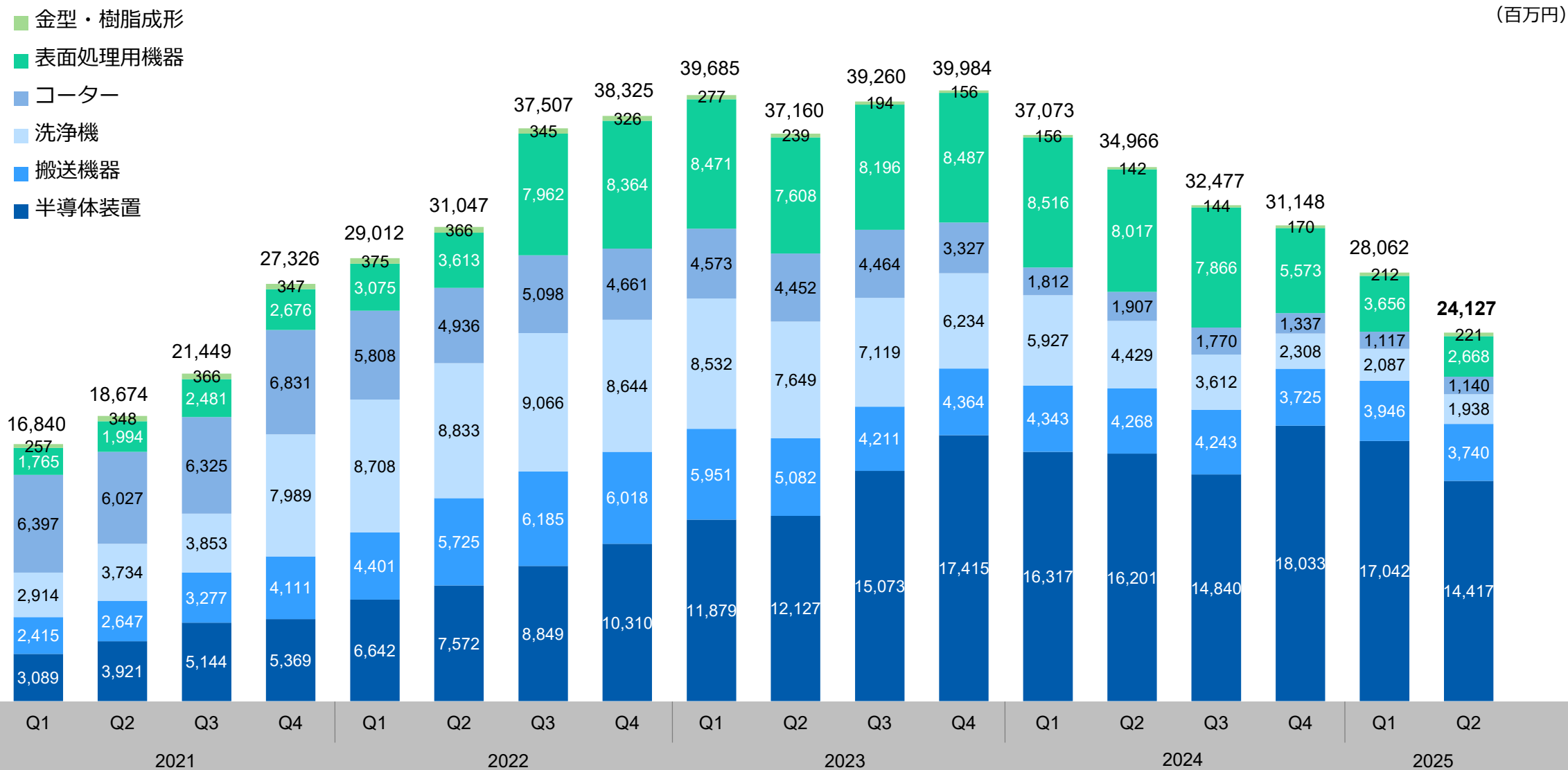
(百万円)



セグメント別 受注高推移（通期）



セグメント別 受注残高推移





3

市場（顧客）の状況

- 半導体製造装置は、アドバンスドパッケージ向け装置では引合いはあるものの受注時期が遅れている。パワー半導体向け装置については、特定の地域を中心に徐々に引合いが出てきており、今後の市場動向を注視している。
- 搬送機器は、市場の停滞や短納期化の傾向にあり受注に苦戦している。国内向けではEFEMなどの高付加価値案件の受注拡大が進みつつある。
- PLP対応装置の引合いが増えている中で確実に受注できるよう対応しており、今後の市場の拡大を期待している。また、PLP用ロボットの引合いも増えてきている。
- リン酸再生装置、スラリー供給装置で引合いがでてきている。洗浄装置では、新規案件の積極的な受注に取り組んでいる。
- 表面処理用機器は、めっき処理装置の投資計画の先送りなどもあり受注状況は一段落感がある。新規開発案件に注力しながら受注を拡大するべく活動中。基板関連の搬送では、自動化の推進により引合いが増加している。

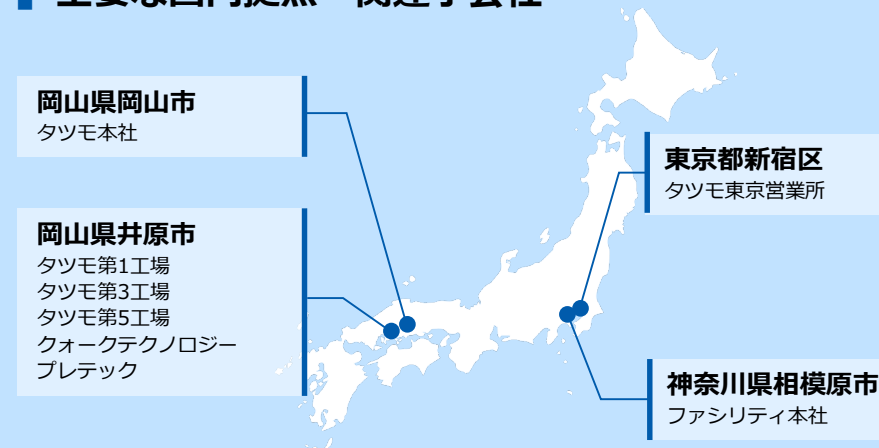


4

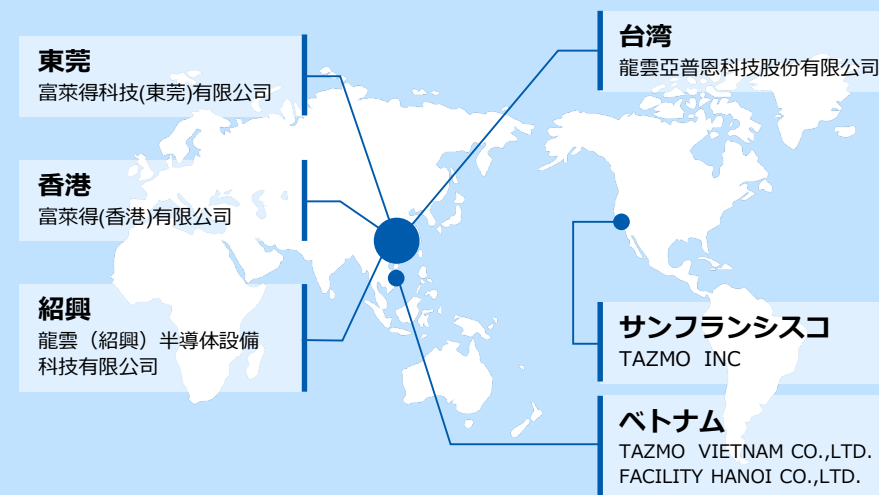
補足資料

商号	タツモ株式会社
設立	1972年（昭和47年）2月26日
本社所在地	岡山県岡山市北区芳賀5311
資本金	35億6,859万682円
発行済株式数	14,842,354株
株主数	9,701名（2025年6月30日現在）
従業員数	単体 436名／連結 1,180名（2025年6月30日現在）
事業内容	半導体製造装置、半導体製造用搬送装置、 紫外線照射装置、めっき処理装置、 精密金型・樹脂成形品などの開発・製造・販売

主要な国内拠点・関連子会社



主要な海外拠点



- | | | | | | |
|------|---|---|------|---|--|
| 1972 | ● | - 電子機器部品の製造及び設備の修繕を目的として設立 | 2009 | ● | - 第10世代対応カラーフィルター製造装置を開発、製造・販売を開始
- 3M社（米国）と半導体製造装置のライセンス契約を締結 |
| 1980 | ● | - インジェクション金型他、金型の製造・販売を開始
- 半導体製造用全自動レジスト塗布装置を開発、製造・販売を開始 | 2013 | ● | - アプリシアテクノロジー株式会社を子会社化
- ロンアン省ロンハウ工業団地内にTAZMO VIETNAM CO.,LTD.を移転・新築 |
| 1989 | ● | - 液晶用カラーフィルター製造装置を開発、製造・販売を開始 | 2017 | ● | - 株式会社ファシリティ、株式会社クオークテクノロジーを子会社化 |
| 1990 | ● | - 本社・本社工場を新築、岡山県井原市木之子町6186番地に移転
- スーパークリーンルーム用超小型搬送システムを開発、製造・販売を開始 | 2018 | ● | - 東京証券取引所市場第一部へ市場変更 |
| 1994 | ● | - エンボスキャリアテープの製造・販売を開始 | 2019 | ● | - 本社を岡山県岡山市北区芳賀5311番地に移転 |
| 1995 | ● | - インジェクション成形品の製造・販売を開始 | 2020 | ● | - アプリシアテクノロジー株式会社を吸収合併 |
| 2001 | ● | - 半導体製造用厚膜コーター「CS13」シリーズを開発、製造・販売を開始 | 2022 | ● | - 東京証券取引所の市場区分の見直しにより、東京証券取引所市場第一部からプライム市場に移行
- 公募増資により、資本金34億9,540万円へ増資
- 中国における半導体関連機器の製造・販売拠点として龍雲（紹興）半導体設備科技有限公司を浙江省紹興市に設立 |
| 2004 | ● | - JASDAQ市場に株式を上場 | | | |
| 2008 | ● | - TAZMO VIETNAM CO.,LTD.（ベトナム：ホーチミン市）を設立 | | | |

最先端の半導体やパッケージを製造する装置をはじめ、クリーン搬送ロボットなどを開発・製造・販売する事業を展開

半導体製造装置事業

半導体製造における塗布・現像・貼合・剥離など、各種プロセスに対応した装置を、40年に渡って培ったノウハウ・技術により、全世界に提供



搬送機器事業

半導体製造に欠かせないシリコンウェーハ等の搬送ロボットをはじめ、正確性・スピーディさ・省スペースに対応した各種搬送システムを提供



洗浄装置事業

半導体製造の重要な工程であるシリコンウェーハ洗浄・スラリー供給装置や、廃液からリン酸を再生・再利用する装置を提供



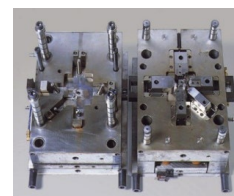
コーター事業

各種フラットパネルディスプレイ用製造装置を提供していたノウハウを生かし、PLP用装置やナノインプリント装置を提供



金型・樹脂成形事業

部品製造に欠かせない金型技術は、創業時からのコア技術であり、ユーザー企業の様々なニーズに応える形で各種製品を提供



表面処理用機器事業

半導体のパッケージや、自動車等の電子制御システムに組み込まれている、プリント回路基板に対するめっき処理装置の提供



本資料の取扱上の注意

本資料に記載されている業績予測等は、現在入手可能な情報に基づいて作成されたものであり、実際の業績は様々な要因により予想数値と異なる場合があります。

また、本資料は投資家の皆様への情報提供のみを目的としたものであり、当社の発行する有価証券売買の勧誘を目的にしたものではありません。

本資料に関するお問い合わせ先

タツモ株式会社 経営企画室



086-239-5000



086-239-5100



keiki@tazmo.co.jp